

宽介电常数聚四氟乙烯玻璃布覆铜箔板 F4BM-1/2

外 观	符合微波印制电路板材料国军标规定指标					
型 号	F4BM220	F4BM255	F4BM265	F4BM300	F4BM350	
介电常数	2.20	2.55	2.65	3.0	3.50	
外型尺寸 (mm)	300×250	350×380	440×550	500×500	460×610	
	600×500	840×840	840×1200	1500×1000		
	特殊尺寸可按客户要求压制					
厚度尺寸及公差 (mm)	板厚	0.25	0.5	0.8	1.0	
	公差	±0.02~±0.04				
	板厚	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
	公差	±0.05~±0.07				
	板厚包括两面铜箔厚度，特殊尺寸可根据客户要求压制					
机 械 性 能	翘 曲 度	板厚 (mm)		翘曲度最大值 mm/mm		
				光面板	单面板	双面板
		0.25~0.5		0.03	0.05	0.025
		0.8~1.0		0.025	0.03	0.020
		1.5~2.0		0.020	0.025	0.015
		3.0~5.0		0.015	0.020	0.010
	剪切 冲剪性能	<1mm 的板剪切后无毛刺，两冲孔间距最小为 0.55mm 不分层。 ≥1mm 的板剪切后无毛刺，两冲孔间距最小为 1.10mm 不分层。				
	抗剥强度	常态≥18N/cm; 恒定湿热及 260℃±2℃熔融焊料中保持 20 秒不起泡、不分层且抗剥强度≥15 N/cm				
化学性能	根据基材特性可参照印制电路化学腐蚀法加工电路，而材料的介质性能不改变，孔金属化需进行钠萘溶液处理或等离子活化处理。					
物 理 电 气 性 能	指标名称		测试条件		单位	指标数值
	比 重		常 态		g/cm3	2.2~2.3
	吸水率		在 20±2℃蒸馏水中浸 24 小时		%	≤0.02
	使用温度		高低温箱		℃	-50~+260
	热导系数				千卡/米小时℃	0.8
	热膨胀数		升温 96℃/小时		热膨胀系数×1	≤5×10-5
	收缩率		沸水中煮 2 小时		%	0.0002
	表面绝缘电阻		500V 直流	常 态	M. Ω	≥1×104
				恒定湿热		≥1×103
	体积电阻		常 态		M Ω .cm	≥1×106
			恒定湿热			≥1×105
	插销电阻		500V 直流	常 态	M Ω	≥1×105
				恒定湿热		≥1×103
	表面抗电强度		常 态		δ =1mm(kv/mm)	≥1.2
			恒定湿热			≥1.1
	介电常数		10GHZ		ε r	2.20 (±2%)
2.65 (±2%)						3.0 (±2%)
3.5 (±2%)						
介质损耗角正切值		10GHZ		tg δ	≤7×10-4	

博锐电路始终坚持"品质至上，服务根本",的原则。为客户提供高效制造及可靠品质，迅速获得最佳的市场和竞争优势，是我们永恒的目标。

如您需要工程技术支持或报价服务,请联系工程技术：eq@brpcb.com；商务报价：sales@brpcb.com Web：www.brpcb.com
陈工10年PCB工程经验，专门为电子工程师提供2-36层（HDI任意阶阻抗）叠层阻抗设计服务 Tel：19195667992 0755-23599845